

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-065

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。为更好地实施公司发展战略，保障公司控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司(以下简称“微组半导体”或“子公司”)日常经营，公司拟为微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过人民币3,000万元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。董事会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次为子公司提供担保事项，子公司其他股东按所享有的权益向提供融资事项的金融机构提供同等比例担保，可以豁免提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司子公司微组半导体向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称

“招商银行深圳分行”）申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，并与招商银行深圳分行签订了《授信协议》。同时，公司与招商银行深圳分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为微组半导体上述《授信协议》项下的债务提供最高额连带责任保证担保。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司微组半导体提供担保的范围内，无需再次提交公司董事会审议。

三、被担保人基本情况

1、微组半导体基本情况

公司名称	深圳市微组半导体科技有限公司
法定代表人	王文
成立时间	2017 年 10 月 18 日
注册资本	1500 万元
统一社会信用代码	91440300MA5ERYA88Q
注册地和主要经营地	深圳市光明区马田街道薯田埔社区星源先进材料产业园 4 栋 1301
与公司存在的关联关系	为公司控股子公司（公司持有微组半导体 70%的股权）
经营范围	一般经营项目：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的研发和销售；提供相关生产工艺的技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备的租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外） 许可经营项目：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。

2、微组半导体股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
深圳市易天自动化设备股份有限公司	1050	70%
王文	262.5	17.5%
林佛迎	45	3%
王贺	37.5	2.5%
万晓峰	30	2%

张艳利	30	2%
蔡木林	30	2%
刘宁	15	1%
合计	1500	100%

3、微组半导体最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	7,565.84	6,360.28
总负债	5,428.37	4,294.31
净资产	2,137.47	2,065.97
营业收入	2,276.97	5,337.83
营业利润	40.25	492.20
净利润	71.50	508.14

注：上述财务数据 2023 年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年半年度未审计。

微组半导体自设立以来严格遵守执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

公司就微组半导体向招商银行深圳分行申请的综合授信额度向招商银行深圳分行出具了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），担保书的主要内容如下：

- 1、保证人：深圳市易天自动化设备股份有限公司。
- 2、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行。
- 3、债务人：深圳市微组半导体科技有限公司。

4、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、保证方式：连带责任保证担保。

6、保证期间：本保证人的保证责任期间自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议通过的对外担保额度总金额为人民币 31,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.00%；实际提供担保总余额为人民币 14,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.93%。公司及子公司无对外担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、微组半导体与招商银行深圳分行签署的《授信协议》；
- 2、公司与招商银行深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年9月27日